

BI Technologies Magnetic Product Termination Material Guide

Last update - 1 Mar 06

Model	Terminal finish solder
BCL	e3
BMB	e3
BMC	e3
BML	e3
HM11	e1
HM12	e1
HM13	e1
HM15	e1
HM18	e1
HM19	e1
HM28	e1
HM31	e1
HM32	e1
HM33	e1 & e3
HM41	e1
HM50	e2
HM51	e2
HM53	e1
HM54	e1
HM55	e1
HM55A	e1
HM61	e1
HM62	obsolete
HM63	obsolete
HM64	e1
HM65	e1 & e3
HM66-10XXX to 70XXX series	e4
HM66-80XXX series	e3
HM67	e3
HM68	e3
HM69	e3
HM70	e1 & e3
HM71-10xxx	e4
HM71-20/30/40/50 series	e3
HM72	e1
HM73	e1
HM74	obsolete
HM75	e1
HM76	e3
HM77	e1
HM78	e3
HM79	e1
HM80	e1
HM100	e1
HS91	e1
HS92	e1
HS93	e1
HT81	e1
HT82	e1
HT83	e1
HT84	e1

Terminal codes per JESD97

- e1 - SnAgCu (shall not be included in category e2)
- e2 - Sn alloys with no Bi or Zn excluding SnAgCu
- e3 - Sn
- e4 - Precious metal (e.g., Ag, Au, NiPd, NiPdAu) (no Sn)
- e5 - SnZn, SnZnx (no Bi)
- e6 - contains Bi
- e7 - low temperature solder (≤ 150 °C) containing Indium (no Bi)